



2026年3月期 第1四半期

(2025年4月1日 ~ 2025年6月30日)

決算補足資料

2025年8月6日

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証プライム 証券コード:6928

(1)	2026年3月期第1四半期決算	P.3
(2)	2026年3月期業績予想	P.9

(1)2026年3月期第1四半期決算



- ・ オプト用リードフレームのハイエンドLED向け、コネクタ用部品のウェアラブル端末向けを中心に増収
- ・ 一方、パワー半導体用リードフレームの民生・産機向けは調整局面が継続
- ・ 利益面では、工場稼働率の改善やメッキの内製化効果により収益力が向上

単位:百万円	2024/3期 1Q		2025/3期 1Q		2026/3期 1Q		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前期比(%)
売上高	6,426	100.0	6,506	100.0	7,146	100.0	+9.8
売上総利益	722	11.2	749	11.5	940	13.2	+25.5
販管費	590	9.2	645	9.9	629	8.8	△2.5
営業利益	132	2.1	104	1.6	311	4.4	+198.3
為替差損益	12	0.2	5	0.1	12	0.2	-
経常利益	162	2.5	135	2.1	336	4.7	+148.1
四半期純利益	96	1.5	47	0.7	263	3.7	+458.6
1株当たり 四半期純利益	14.52円	-	7.04円	-	41.27円	-	

四半期別業績報告(第1四半期)

- ・ オプト用リードフレーム、コネクタ用部品を中心に前期から増収継続
- ・ スマートフォンの新規モデル向けが出荷開始。ウェアラブル端末向け及びハイエンドLED向けも順調に増加
- ・ 工場稼働率やメッキ内製化による収益力の向上により前年同期比、前4Q比ともに大幅な増益

単位:百万円	2025/3期					2026/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前同比(%)	4Q比(%)
売上高	6,506	6,912	6,917	6,543	26,880	7,146	+9.8	+9.2
売上総利益	749	902	877	617	3,147	940	+25.5	+52.2
販管費	645	648	620	614	2,528	629	△2.5	+2.4
営業利益	104	253	256	3	618	311	+198.3	+8028.5
為替差損益	5	△61	35	△45	△65	12	-	-
経常利益	135	228	332	△26	669	336	+148.1	-
四半期純利益	47	223	140	37	447	263	+458.6	+603.6

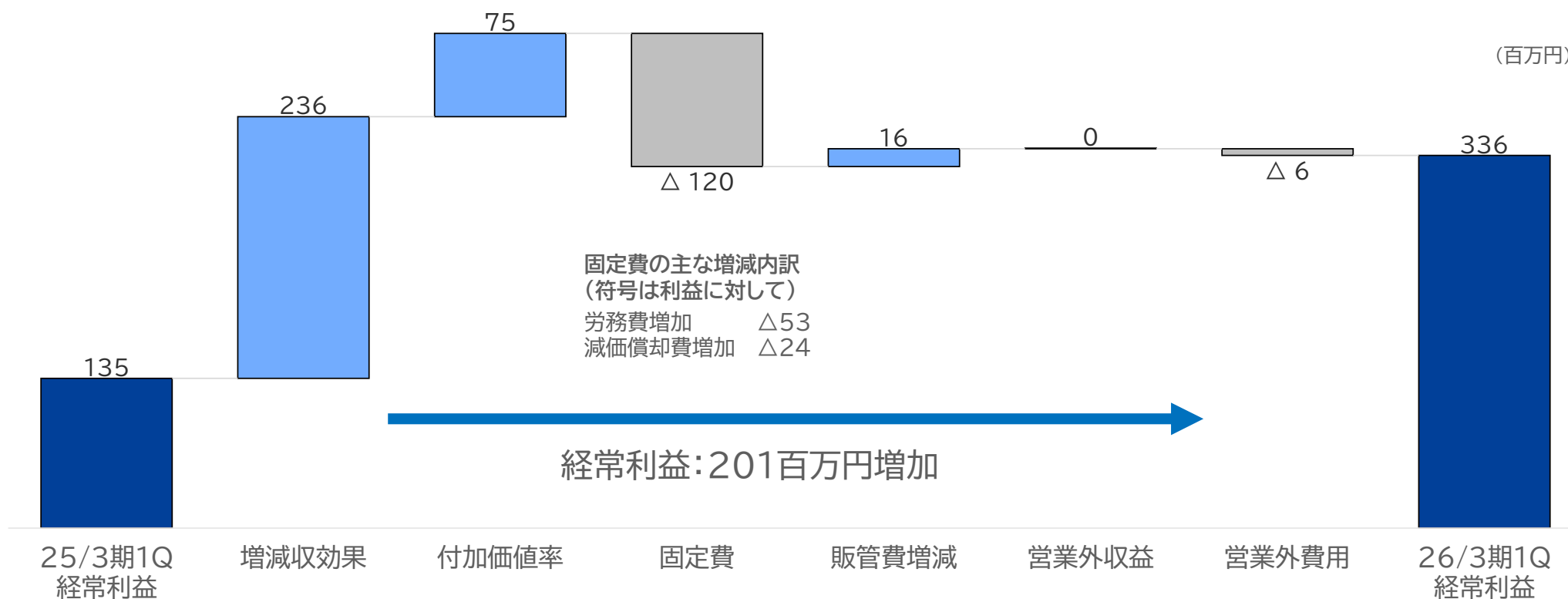
製品群別四半期売上高(第1四半期)

- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けが横ばいの一方で、民生・産機向けは在庫調整が続く
- ・ オプト用リードフレームはハイエンドLED向け製品の量産が本格化し、増加傾向が持続
- ・ コネクタ用部品はスマートフォンの新規モデル向け出荷が開始し堅調、ウェアラブル端末向け・車載向けともに増加

単位:百万円	2025/3期					2026/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前同比(%)	4Q比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	2,662	2,734	2,738	2,637	10,771	2,615	△1.8	△0.8
オプト用 リードフレーム	728	742	901	998	3,371	1,108	+52.1	+10.9
コネクタ用部品	2,959	3,248	3,114	2,763	12,085	3,264	+10.3	+18.1
その他	156	188	163	144	651	158	+1.7	+10.3
合計	6,506	6,912	6,917	6,543	26,880	7,146	+9.8	+9.2

経常利益増減要因(第1四半期)

- 増減収効果 オプト用リードフレーム、コネクタ用部品のウェアラブル端末向け等が増収
- 付加価値率 ①メッキの内製化による、付加価値の取り込み
②オプト用リードフレームのハイエンド品の増加
- 固定費 ①マイクロコネクタの生産による金型減価償却費増加
②労務費が賃上げと生産高上昇に伴い増加



用途別量産品売上構成比(第1四半期)

- ・ 車載はパワー半導体用リードフレームが横ばい、エアバッグ向けコネクタは堅調
- ・ スマートフォンは新規モデル向け等の出荷が開始、ウェアラブル向けも増加
- ・ 民生・産機・その他の汎用パワー半導体用リードフレームは調整継続、オプト用リードフレームはハイエンド品が順調に増加

民生・産機・その他

- ・ 構成比は前年同期の26.1%から2.6pt増加
前年同期比16.8%増加
- ・ PC向けを含む汎用パワー半導体用
リードフレームの在庫調整
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品の
出荷開始により増加

ウェアラブル

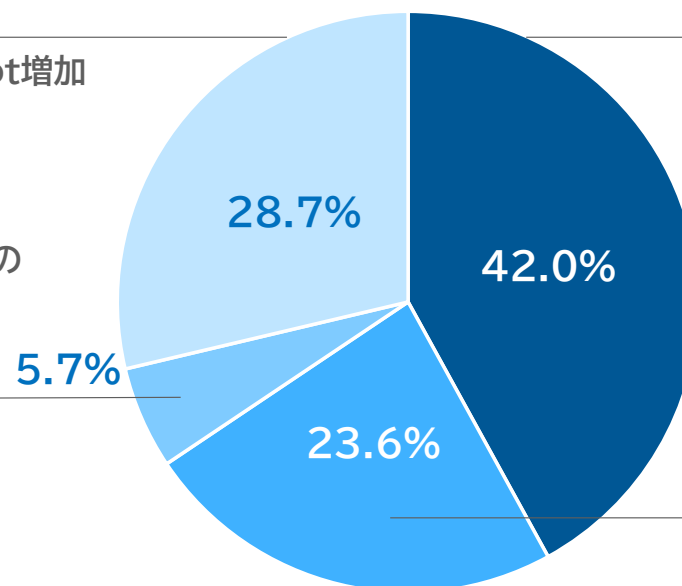
- ・ 構成比は前期同期同等の5.7%
前年同期比7.5%増加
- ・ ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、
スマートグラス等の新製品向けで増加

車載

- ・ 構成比は前年同期の43.0%から1.0pt減少
前年同期比4.2%増加
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームは横ばい
- ・ エアバッグ向けコネクタ等は堅調

スマートフォン

- ・ 構成比は前年同期の25.2%から1.6pt減少
前年同期比0.2%減少
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の
新規モデル向けが出荷開始、
前年同期と同水準の売上で推移



(2)2026年3月期業績予想



業績予想

- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品が民生向けに続き車載向けも順次量産開始の予定で、着実な成長が続く
- ・ メッキや樹脂成形が必要な高付加価値製品をターゲットに受注活動強化、製造工程の自動化を加速し、増益を予想
- ・ 米国の関税政策による直接的な影響は僅少だが、金融・為替相場の混乱による景況の悪化など間接的な影響を注視

単位:百万円	2024/3期		2025/3期		2026/3期		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	25,244	100.0	26,880	100.0	27,000	100.0	+0.4
売上総利益	2,654	10.5	3,147	11.7	3,600	13.3	+14.4
販管費	2,494	9.9	2,528	9.4	2,600	9.6	+2.8
営業利益	160	0.6	618	2.3	1,000	3.7	+61.6
経常利益	291	1.2	669	2.5	1,050	3.9	+56.9
当期純利益	121	0.5	447	1.7	700	2.6	+56.3
1株当たり当期純利益	18.16円	-	68.51円	-	107.07円	-	-
配当金	70.0円	-	71.0円	-	71.0円	-	-

製品群別売上高予想

- ・ パワー半導体向けリードフレームは中国の民生・産業機器向けが調整継続
- ・ オプト用リードフレームはハイエンドLED向けの量産が順次開始、増収が続く
- ・ コネクタ用部品は全体的に堅調な予測で、ウェアラブル端末向けの更なる成長に期待

単位:百万円	2024/3期		2025/3期		2026/3期		前期比(%)
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,112	44.0	10,771	40.1	10,000	37.0	△7.2
オプト用 リードフレーム	2,647	10.5	3,371	12.5	4,300	15.9	+27.6
コネクタ用部品	10,989	43.5	12,085	45.0	12,200	45.2	+1.0
その他	495	2.0	651	2.4	500	1.9	△23.3
合計	25,244	100	26,880	100.0	27,000	100.0	+0.4

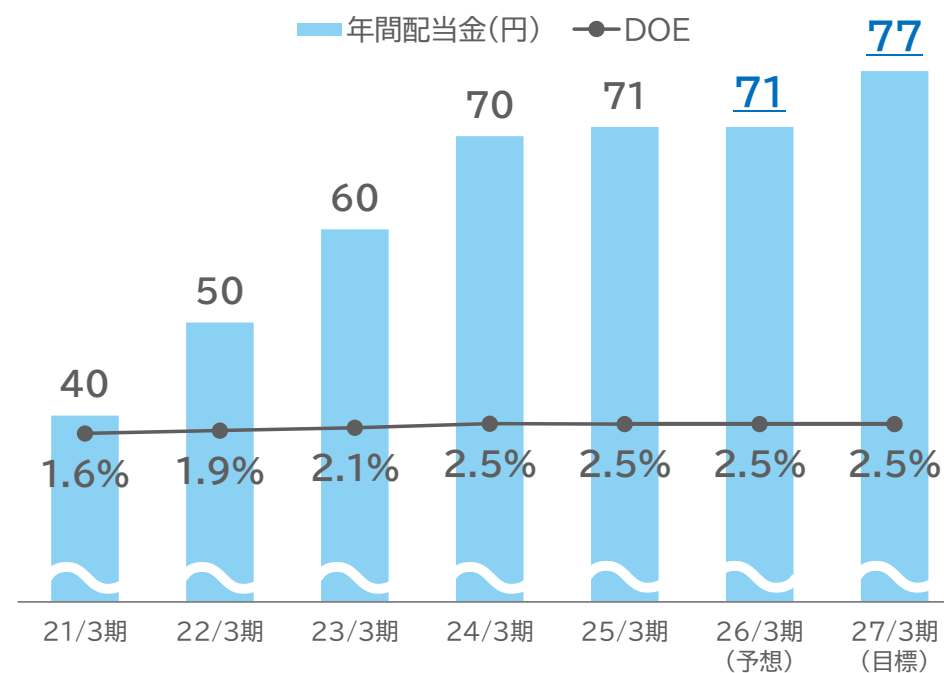
- ・ 2023年5月に配当方針をDOE2.5%以上に変更、2026年3月期もDOE2.5%以上となる71円の配当を継続

2024年3月期以降の配当方針

- ・ DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- ・ 中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- ・ 2026年3月期は71円配当を予定 (DOE2.5%)

* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

配当金・DOEの推移





注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。